**附件:**

**第十五届中国半导体创新产品和技术项目评选申报表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  | | | | | | | | 注册地 | |  | |
| 通讯地址 |  | | | | | | | | 邮 编 | |  | |
| 网 址 |  | | | | | | | | | | | |
| 法人代表 | 姓 名 | |  | | | | 职 务 | |  | | | |
| 电 话 | |  | | | | 传 真 | |  | | | |
| 手 机 | |  | | | | 电子邮件 | |  | | | |
| 联系人 | 姓 名 | |  | | | | 职 务 | |  | | | |
| 电 话 | |  | | | | 微 信 号 | |  | | | |
| 手 机 | |  | | | | 电子邮件 | |  | | | |
| 项目名称  （含产品名称和型号或技术名称） | | |  | | | | | | | | | |
| 产品或技术类型（请在右边的“□”内打“√”）：  集成电路产品 □ 集成电路设计技术（含EDA/IP） □ 半导体分立器件（含模块） □  光电器件 □ MEMS □ 集成电路制造技术 □ 集成电路封装与测试技术 □  半导体专用设备 □ 半导体专用材料 □ | | | | | | | | | | | | |
| 成果主要完成人（不超过5人，依据贡献大小排序） | | | | | | | | | | | | |
| 序号 | | 姓名 | | 性别 | 年龄 | | | 职务职称 | | 工作单位 | | 联系电话 |
| 1 | |  | |  |  | | |  | |  | |  |
| 2 | |  | |  |  | | |  | |  | |  |
| 3 | |  | |  |  | | |  | |  | |  |
| …… | |  | |  |  | | |  | |  | |  |
| 产品或技术的鉴定、  验收评价机构 | | | |  | | | | | | | | |
| 参评项目及其简要介绍  （300字以内） | | | |  | | | | | | | | |
| 创新性描述  其中：产品或者技术属于原始创新、集成创新和消化吸收创新三种创新形式中的哪一种？并说明创新的部分  （800字以内） | | | |  | | | | | | | | |
| 先进性描述  产品或技术在国际、国内同行业中的先进性  （300字以内） | | | |  | | | | | | | | |
| 产品或技术发明专利和自主知识产权情况  （300字以内） | | | |  | | | | | | | | |
| 成果物应用情况  其中：产品（或技术）的应用范围和用户情况、市场前景  （800字以内） | | | |  | | | | | | | | |
| 产品的销售量和销售收入（采用该项技术形成的销售收入或技术转让收入）  （300字以内） | | | |  | | | | | | | | |
| 申报单位：  负责人签字：  单位签章： 年 月 日 | | | | | | 推荐单位：  签章： 年 月 日 | | | | | | |

备注：有关栏目文字超出，可另附页。